

论坛日程

Forum Agenda

9月24日，星期三 Wednesday, 24 September			
上午	10:10-11:50	N4B50论坛区	10:10-11:50N4E50论坛区
	宽禁带半导体—氮化镓 WBG_GaN (主持人即将公布)		电力电子技术 Power Electronics (主持人即将公布)
	11:50-13:20	午餐 Lunch break	
下午	13:20-16:20	N4B50论坛区	13:20-16:20N4E50论坛区
	功率器件（一） Power Devices I (主持人即将公布)		材料与封装 Materials & Packaging (主持人即将公布)

9月25日，星期四 Thursday, 25 September			
上午	10:00-12:00	N4B50论坛区	10:00-12:00N4E50论坛区
	电气化交通 E-Mobility (主持人即将公布)		功率器件（二） Power Devices II (主持人即将公布)
	12:00-13:20	午餐 Lunch break	
下午	13:20-16:00	N4B50论坛区	13:20-16:00N4E50论坛区
	宽禁带半导体—碳化硅 WBG_SiC (主持人即将公布)		人工智能与数据中心 AI & Data Center (主持人即将公布)

论坛赞助商 Forum Sponsors





演讲单位 Speakers

















































































*排名不分先后 Not in specific order

论坛日程

Forum Agenda

9月24日， 星期三 Wednesday, 24 September		
上午	N4B50论坛区	N4E50论坛区
	宽禁带半导体—氮化镓 WBG_GaN (主持人即将公布)	电力电子技术 Power Electronics (主持人即将公布)
	10:10-10:30 英飞凌CoolGaN™ G5 重新定义功率密度 程文涛，英飞凌科技， 消费、 计算与通讯业务大中华区市场总监 Infineon Technologies AG	10:10-10:30 以电力电子高可靠应用为导向的SiC MOSFET动态可靠性创新测试解决方案 毛赛君， 忱芯科技 (上海) 有限公司， 总经理 UniSiC Technology (Shanghai) Co., Ltd.
	10:30-10:50 罗姆GaN Device助力高效电源设计 李素娟， 罗姆半导体 (上海) 有限公司， 经理 ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	10:30-10:50 Technologies for WBG power semiconductor characterization – Static to dynamic characterization Tom Neville, Worldwide Business Development Manager, Keysight Technology Inc. 是德科技 (中国) 有限公司
	10:50-11:10 Next Generation GaN: Displacing Silicon in Low-Voltage Power Conversion Alex Lidow, CEO, Efficient Power Conversion (EPC) 宜普电源转换公司	10:50-11:10 西门子Simcenter TEST Micred 高精度热阻测试与功率循环实验 张虎， 西门子工业软件 (上海) 有限公司， Micred大中国区产品经理 Siemens Industry Software (Shanghai) Co., Ltd.
	11:10-11:30 氮化镓如何高效赋能48 V电机驱动应用 成皓， 安世半导体， GaN产品线资深市场拓展经理 nexperia	11:10-11:30 汽车主驱逆变器烧结工艺整体解决方案 凌晓渊， 奥芯明半导体设备技术 (上海) 有限公司， 汽车功率半导体业务负责人 AMSPT
	11:30-11:50 Powering the Future: GaN Innovation for Next-Gen Applications Min Chen, Vice President of GaN IC Products, Innoscience (Shenzhen) Semiconductor Co.,Ltd. 英诺赛科 (深圳) 半导体有限公司	11:30-11:50 SiC功率半导体测试及驱动解决方案 程加昌， 杭州飞仕得科技有限公司， 设备事业部副总经理 Hangzhou Firstack Technology Co., Ltd.
下午	11:50-13:20	午餐 Lunch break
	N4B50论坛区	N4E50论坛区
	功率器件 (一) Power Devices I (主持人即将公布)	材料与封装 Materials & Packaging (主持人即将公布)
	13:20-13:40 【 题目待定 】 英飞凌科技 Infineon Technologies AG	13:20-13:40 下一代电力电子先进封装材料与系统集成 胡彦杰， 镅泰公司， 华东区高级技术经理 Indium Corporation
	13:40-14:00 Bosch SiC portfolio and advantages to enable CN NEV development and fulfill customers' demand Anne Bedacht, Director Product Management Power SC, Bosch (China) Investment Ltd. 博世 (中国) 投资有限公司	13:40-14:00 低温烧结纳米银、 铜产品及其面向汽车应用的封装互连技术 梅云辉， 广州汉源微电子封装材料有限公司， 技术专家 Solderwell Microelectronic Packaging Materials Co.,Ltd.
	14:00-14:20 面向铁路和电力系统应用的高压IGBT和SiC模块 胡博， 三菱电机机电 (上海) 有限公司， 应用技术副经理 Mitsubishi Electric & Electronics (SHANGHAI) CO., LTD.	14:00-14:20 Macdermid Alpha Bondpad®功率芯片顶部烧结方案 赵宇， 麦德美爱法， 高级业务发展经理 MacDermid Alpha
	14:20-14:40 100千瓦： 用于兆瓦级电动汽车充电的下一代模块 Hank Zhao， 安森美， 电源方案事业部市场拓展经理 onsemi	14:20-14:40 【 题目待定 】 上海贺利氏工业技术材料有限公司 Heraeus Materials Technology Shanghai Ltd.
	14:40-15:00 轨道交通中适用于3.3kV碳化硅MOSFET的可靠驱动解决方案 安芳， Power Integrations， 高级系统工程师	14:40-15:00 功率器件全烧结方案与挑战 贾强， 北京清连科技有限公司， 董事长 Beijing QLsemi Technology Co.,Ltd.
	15:00-15:20 拓展适用于1500V系统的2kV碳化硅产品系列 朱凤杰， 赛米控丹佛斯电子 (珠海) 有限公司， 现场应用中国区经理 Semikron Danfoss Electronics (Zhuhai) Co., Ltd.	15:00-15:20 CeramTec 电力电子产品品质提升计划 范围， CeramTec GmbH， 中国区销售总监
	15:20-15:40 安世车规CCPAK1212 MOSFET ， 提供更高功率密度解决方案 罗金， 安世半导体， MOS产品线中国区市场经理 nexperia	15:20-15:40 适用于功率器件的甲酸回流炉锡膏助焊剂技术开发 株式会社弘辉 KOKI COMPANY LIMITED
	15:40-16:00 东芝碳化硅技术和产品 屈兴国， 东芝电子元件 (上海) 有限公司， 技术部 副总监 Toshiba Devices & Storage (Shanghai) Co., Ltd.	15:40-16:00 有压纳米银烧结工艺量产应用实践与检讨 田天成， 苏州宝士曼半导体设备有限公司， 总经理 Suzhou Boschman Semiconductor Equipment Co., Ltd.
	16:00-16:20 【 题目待定 】 昆芯 (上海) 科技有限公司 KUNSEMI (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD.	16:00-16:20 纳米铜复合焊料： 助力功率模块实现低温高可靠连接 杨帆， 深圳芯源新材料有限公司， 研发总监 Shenzhen Xinyuan New Material Co.,Ltd.

论坛日程

Forum Agenda

9月25日, 星期四 Thursday, 25 September

9月25日， 星期四 Thursday, 25 September		
上午	N4B50论坛区	N4E50论坛区
	电气化交通 E-Mobility (主持人即将公布)	功率器件 (二) Power Devices II (主持人即将公布)
	10:00-10:20 【 题目待定 】 英飞凌科技 Infineon Technologies AG	10:00-10:20 【 题目待定 】 北京华瑞赛晶电子科技有限公司
	10:20-10:40 半导体断路器重新定义电动汽车功率分配 韩少韦, 威世 (中国) 投资有限公司, 汽车业务拓展经理 Vishay	10:20-10:40 中车电力电子技术与应用 余伟, 株洲中车时代半导体有限公司, 应用解决方案负责人 ZHUZHOU CRRC TIMES SEMICONDUCTOR CO., LTD
	10:40-11:00 Advanced Power Modules for Automotive Trasction Applications 范健, 赛米控丹佛斯电子 (珠海) 有限公司, 大客户经理 Semikron Danfoss Electronics (Zhuhai) Co., Ltd.	10:40-11:00 Siemens EDA高效功率模块设计、 仿真和自动寻优平台 尤立夫, 西门子电子科技 (上海) 有限公司, 技术市场工程师 Siemens Electronic Design Automation (Shanghai) Co., Ltd.
	11:00-11:20 驱动未来：提升效率以激发创新 Marcus Kneifel, 安森美, 全球高级副总裁 onsemi	11:00-11:20 集成硅基RC缓冲器——宽禁带器件效能跃升的经济方案 叶常生, 迈来芯电子科技 (上海) 有限公司, 产品线总监 Melexis
	11:20-11:40 Investigation on direct liquid cooling design of power modules with flat baseplate for automotive application 陈磊, 富士电机 (中国) 有限公司, 经理 Fuji Electric (China) Co., Ltd.	11:20-11:40 LLC谐振拓扑核心功率器件选型 史献冰, 瑶芯微 (上海) 电子科技股份有限公司, 市场总监 Alkaid-Semi Technologies (Shanghai) Co.,Ltd.
11:40-12:00 HTV150 Dielectric Film for High Heat DC-Link Capacitors with Minimal Derating of Operating Voltage Adel Bastawros, Chief Scientist, SABIC 沙特基础工业公司	11:40-12:00 永铭电容器配合功率器件新方案和第三代半导体新方案的创新应用 王永明, 上海永铭电子股份有限公司, 总裁 Shanghai Yongming Electronics Co., Ltd.	
12:00-13:20 午餐 Lunch break		
N4B50论坛区	N4E50论坛区	
宽禁带半导体—碳化硅 WBG_SiC (主持人即将公布)	人工智能与数据中心 AI & Data Center (主持人即将公布)	
13:20-13:40 【 题目待定 】 英飞凌科技 Infineon Technologies AG	13:20-13:40 人工智能在电力电子系统中的应用 马皓教授, 浙江大学 Zhejiang University	
13:40-14:00 ROHM SiC功率模块的应用 倪敏, 罗姆半导体 (上海) 有限公司, 高级经理 ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	13:40-14:00 英飞凌为AI服务器提供高效率/高功率密度供电方案 – PSU 和IBC 方案介绍 卢柱强, 英飞凌科技, 消费、计算与通讯业务大中华区应用市场总监 Infineon Technologies AG	
14:00-14:20 SiC DIPIPM助力高能效变频家电 王小岭, 三菱电机机电 (上海) 有限公司, 高级经理 Mitsubishi Electric & Electronics (SHANGHAI) CO., LTD.	14:00-14:20 船舶电气化与数字化展望 黄易梁, ABB船舶智能控制	
14:20-14:40 面向电动汽车应用的SiC功率模块和芯片 赵利忠, 三菱电机机电 (上海) 有限公司, 副经理 Mitsubishi Electric & Electronics (SHANGHAI) CO., LTD.	14:20-14:40 AI电源市场趋势、下一代数据中心架构及安森美解决方案 WK Chong, 安森美, 应用工程高级经理 onsemi	
14:40-15:00 新型高功率封装 HPnC, 适用于 1500 VDC 应用的 2.3 kV SiC MOSFET 江亚威, 富士电机 (中国) 有限公司, 经理 Fuji Electric (China) Co., Ltd.	14:40-15:00 多电平逆变器智能诊断与容错控制 王天真教授, 上海海事大学 Shanghai Maritime University	
15:00-15:20 Bosch SiC technology and robustness to ensure long-term safety and efficiency in NEV Steffen Beushausen, Technical Expert Power Electronics, Bosch (China) Investment Ltd. 博世 (中国) 投资有限公司	15:00-15:20 提高转换效率和散热管理赋能高效可靠 AI 电源 杨益彰, 威世 (中国) 投资有限公司, 亚洲区业务开发资深总监 Vishay	
15:20-15:40 SiC 功率器件：重塑新能源格局的核芯技术解决方案 袁建, 飞矽半导体 (上海) 有限公司, 产品市场总监 APS Shanghai Ltd.	15:20-15:40 Nexperia热插拔技术：赋能AI服务器高功率与高可靠性 李林凯, 安世半导体, IC产品线资深首席系统工程师 nexperia	
15:40-16:00 【 题目待定 】 江苏宏微科技股份有限公司 MACMIVC SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	15:40-16:00 AI 驱动的工商业光储联合系统及工程应用 孙耀杰教授, 复旦大学 Fudan University	